



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D213830 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 09 月 11 日

(21)申請案號：108306619

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 10 月 24 日

(51)LOC.(11)Cl.：15-99

(30)優先權：2019/04/25 日本

2019-009324

(71)申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本

(72)設計人：天野嘉文 AMANO, YOSHIFUMI (JP)；相浦一博 AIURA, KAZUHIRO (JP)

(74)代理人：周良吉；周良謀

(56)參考文獻：

TW I580479

TW D148750

TW D186857

TW D186858

US D481743

US D771248

US D783784

US D789790

審查人員：徐銘峯

圖式數：8 共 6 頁

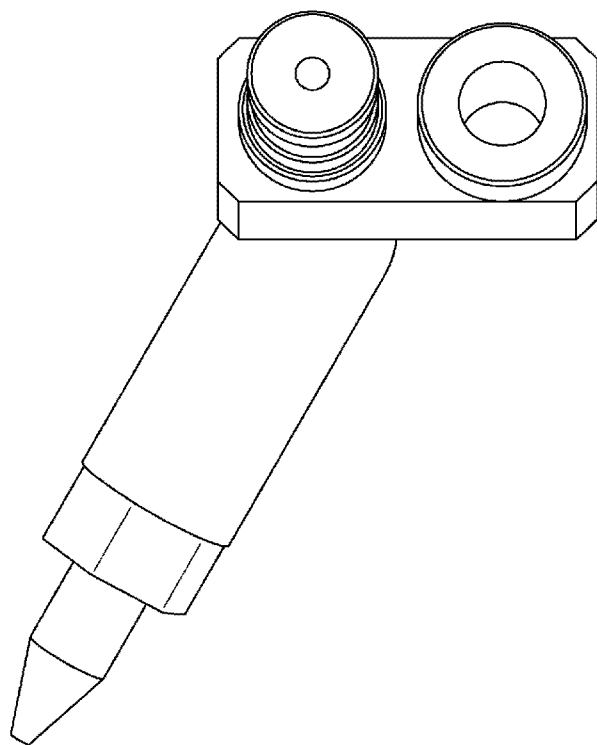
(54)名稱

液體噴吐用噴嘴

代表圖：

D213830

TW D213830 S



【立體圖】



公告本

D213830

【設計說明書】

【中文設計名稱】 液體噴吐用噴嘴

【物品用途】

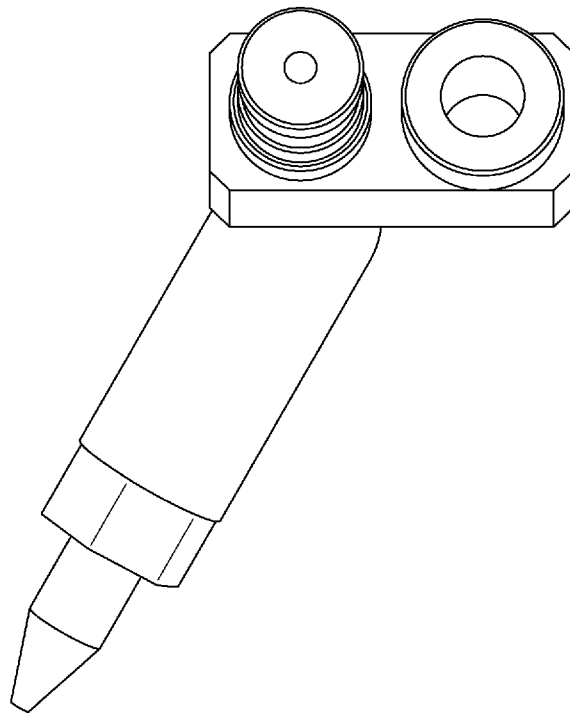
【0001】

本設計物品係使用於基板處理裝置之液體噴吐用噴嘴，該基板處理裝置係於半導體元件等之製程中，藉由對於半導體晶圓等基板供給處理液，而實施蝕刻等既定之基板處理。如同「表示使用狀態之參考圖」所示，本設計物品係安裝於基板處理裝置而使用，並使處理液從本設計物品的前端對於基板之周緣部(斜角部)噴吐而進行該基板處理。

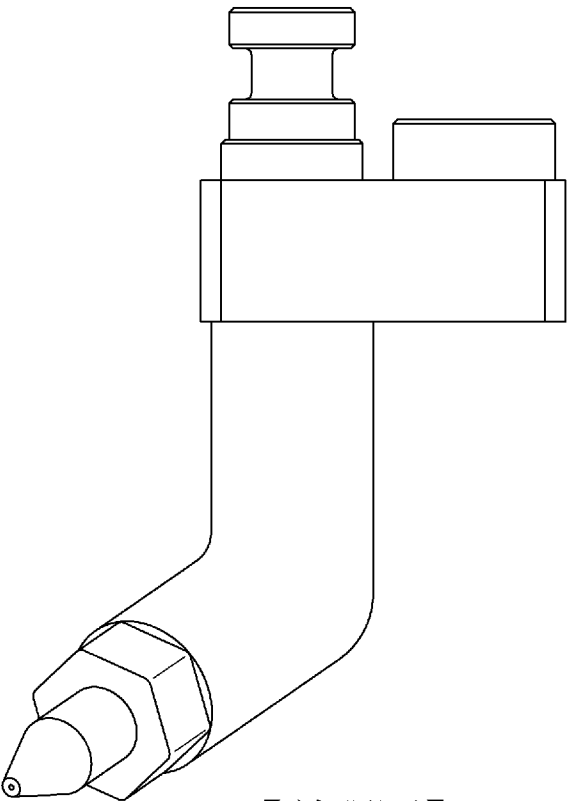
【設計說明】

無。

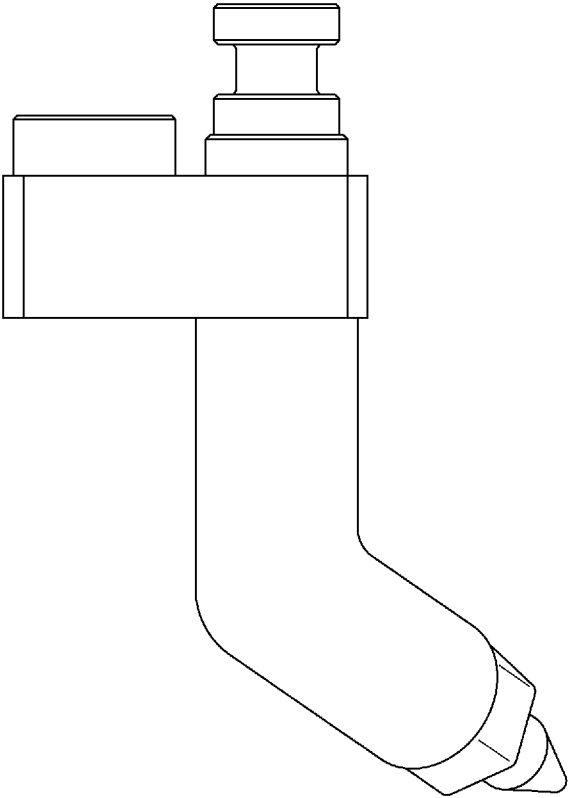
【設計圖式】
(指定代表圖)



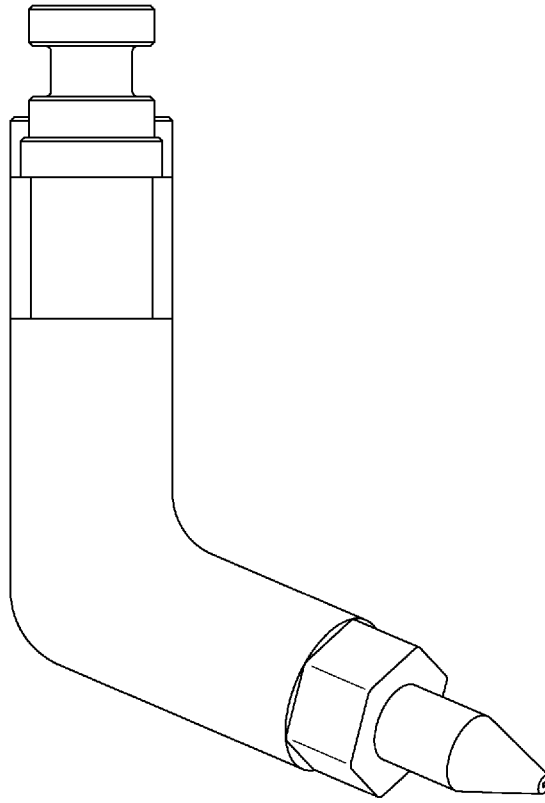
【立體圖】



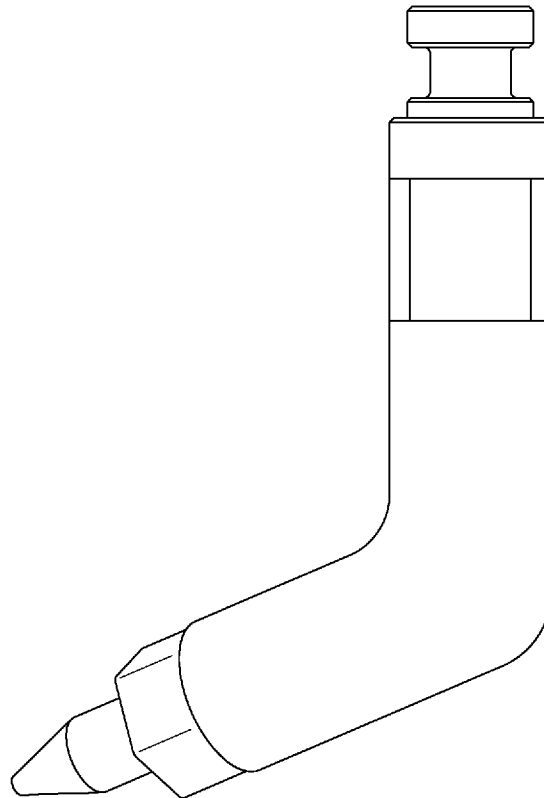
【前視圖】



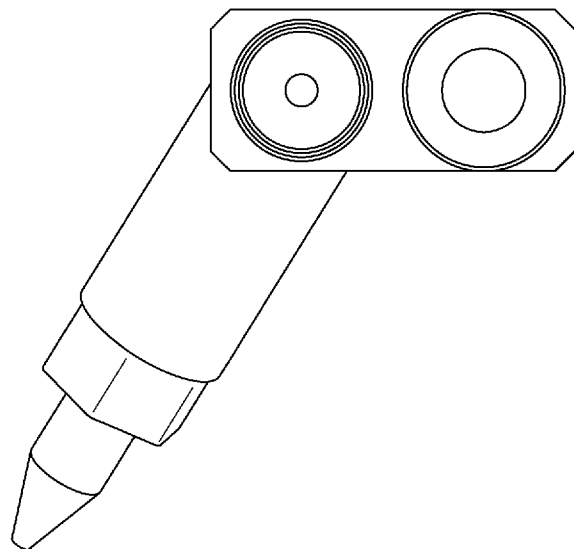
【後視圖】



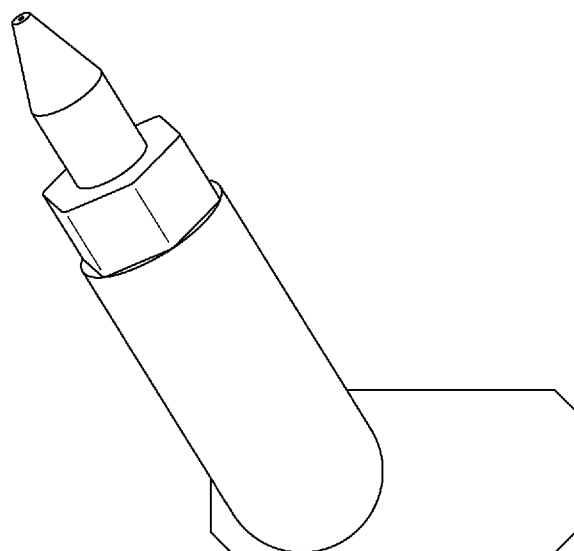
【左側視圖】



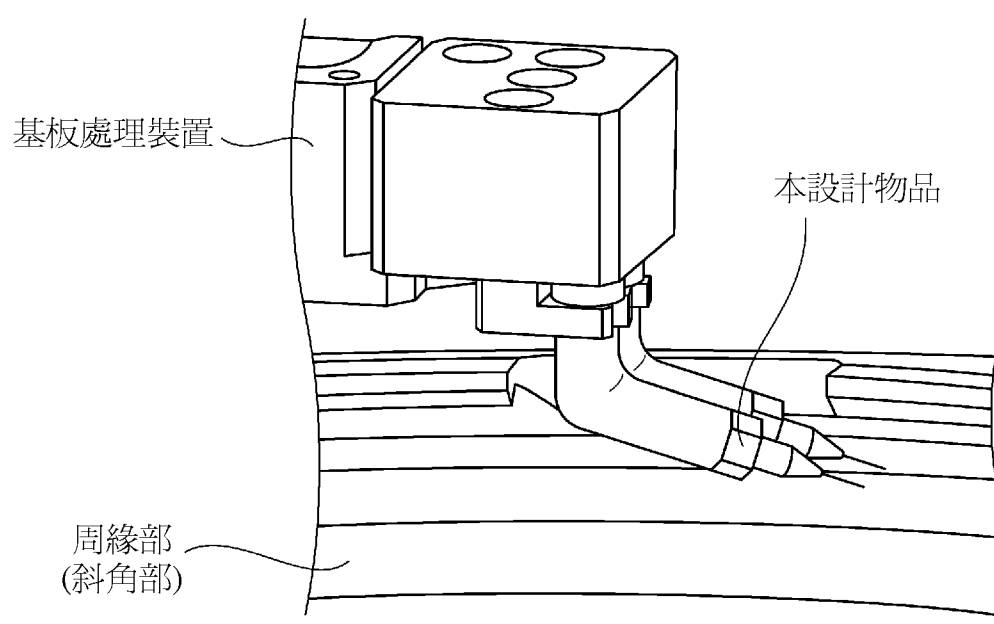
【右側視圖】



【俯視圖】



【仰視圖】



【表示使用狀態之參考圖】